

Laser-Kunststoffschweißen auf der productronica

Ansprechpartner:

Cordula Krause-Widjaja
cordula.krause-
widjaja@lpkf.com
Tel. +49 (5131) 7095-1327
Fax +49 (5131) 7095-90

LPKF WeldingQuipment GmbH

Alfred-Nobel-Str. 55-57
90765 Fürth
Germany

Amtsgericht Fürth: HRB 14026
USt.-IdNr.: DE 289091188

» www.lpkf.com

Member of LPKF Group

Aktien: Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» [Weitere Pressemeldungen](#)

Die Vorteile des Laserverfahrens beim Fügen von Kunststoffgehäusen für die Elektronik präsentiert LPKF auf der Weltleitmesse für Elektronik vom 16. – 19. November in München. Neben den verschiedenen Möglichkeiten, unterschiedliche Laserschweißverfahren für verschiedene Bauteilgeometrien einzusetzen, stehen zwei Neuheiten im Fokus. Zum einen das neue Lasersystem LPKF InlineWeld 2000. Zum anderen eine technologische Neuheit: Hochintegrierte elektronische 3D-Bauteile können jetzt mit LPKF-Lasersystemen direkt verschweißt werden.

Leiterplatten müssen für viele Anwendungen in Kunststoff-Housings montiert werden, da das Material aufgrund seiner Eigenschaften optimal für Gehäuse geeignet ist. Mit verschiedenen Laserverfahren können die Gehäusebauteile präzise, sauber und sicher gefügt werden. Die Anwendung kann in Bezug auf Nahtstärken und Geometrie äußerst flexibel erfolgen. Das Leiterplattenmaterial wird beim Schweißprozess nicht beeinträchtigt – ein wichtiger Punkt insbesondere für Applikationen im Bereich Medizintechnik oder im innovativen Feld der E-Mobility. Dass auch sehr spezielle Formen mit dem Laser gefügt werden können, zeigt das Unternehmen auf der Messe am Beispiel des neuen Lasersystems LPKF InlineWeld 2000, das ein Spezialsystem zum Schweißen rotationssymmetrischer Bauteile ist.

Darüber hinaus stellt das Unternehmen vor, wie sich ein spezielles Material, das für die Laser Direktstrukturierung (LDS) eingesetzt werden kann, mit LPKF-Systemen fügen lässt. Bei der LDS werden Leiterbahnen mit elektronischen Funktionen direkt auf der Oberfläche eines Formteils erzeugt, wobei diese Integration mechanischer und elektronischer Funktionen auf einem Teil entscheidend zur Miniaturisierung beiträgt. Die Möglichkeit, das Material nun mit den Laserschweißanlagen von LPKF zu fügen, ist weltweit einzigartig und kann zukünftig eines der führenden Verfahren in der sogenannten Molded Interconnect Device-Technologie weiter voranbringen.



Abb.: Der Rotationsarm in der LPKF InlineWeld 2000 ermöglicht die präzise Strahlführung beim Laserschweißprozess.

Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.